

【111 學年度第 1 學期起適用】  
111.10.31 111 學年度第 1 學期學分學程會議通過  
111.12.5 第 174 次教務會議通過

## 數位 IC 設計學程課程規劃表

			課程名稱	開課系所	學分數	備註
專業核心 (必修)	大學	基礎	電路學 (一)	電機系	3	必選
			電子學 (一)	電機系	3	
			數位系統設計/數位系統	電機系/資工系	3	
			VLSI 設計導論	電機系	3	
	進階	計算機組織	電機系/資工系	3		
		硬體描述語言	電機系/資工系	3		
		實用數位系統設計	電機系	3		
	研究所	專業	系統晶片設計	電機碩	3	
			系統晶片測試	電機碩	3	
			超大型積體電路數位訊號處理	電機碩	3	
核心課程〈專業模組課程〉學分數： 30 學分						
選修課程	研究所	專業輔助	高等計算機結構	電機碩	3	任選 1 門
			FPGA 系統設計實務	電機碩	3	
			SOPC 設計實務及 FPGA 系統整合設計	資工碩	3	
			電子系統層級設計與驗證	資工碩	3	
	專業分項	高可靠度系統之設計、測試與應用	電機碩	3		
		數位通訊電路設計	電機碩	3		
		算術處理器設計與實作	資工碩	3		
應修課程學分數：3 學分						
總學分數：至少 33 學分						
※【整合學程】課程規劃至少 33 學分。 ※【整合學程】學生所修習之學程課程中，至少應有 6 學分不屬於學生本系所、雙主修及輔系之課程。 ※修習學程適用之課程規劃表請依核准修習學年期版本為主。						